

Title (en)

Process for the activation of surfaces for electroless metallization.

Title (de)

Verfahren zur Aktivierung von Substratoberflächen für die stromlose Metallisierung.

Title (fr)

Procédé d'activation des surfaces pour la métallisation sans courant.

Publication

EP 0082438 A1 19830629 (DE)

Application

EP 82111461 A 19821210

Priority

DE 3150985 A 19811223

Abstract (en)

[origin: US4493861A] A simple and mild method of activating substrate surfaces for currentless metallization involves activating by means of organometallic compounds of elements of the 1st and 8th sub-Groups of the Periodic Table of Elements in which the organic moiety consists of oligomeric, prepolymeric or polymeric compounds containing double bonds.

Abstract (de)

Eine schonende und verfahrenstechnisch einfache Methode zur Aktivierung von Substratoberflächen zum Zwecke der stromlosen Metallisierung besteht darin, daß man zur Aktivierung metallorganische Verbindungen von Elementen der 1. und 8. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente verwendet, deren organischer Teil oligomere, präpolymere oder polymere Verbindungen sind, die Doppelbindungen enthalten.

IPC 1-7

C23C 3/00

IPC 8 full level

C23C 18/30 (2006.01); **C08J 7/04** (2006.01); **C23C 18/16** (2006.01); **C23C 18/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C23C 18/28 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] US 3523824 A 19700811 - POWERS JOHN V, et al
- [A] IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 11, Nr. 8, Januar 1969, Seite 1001, New York, USA
- [A] IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 13, Nr. 5, Oktober 1970, Seite 1200, New York, USA

Cited by

EP0250867A1; DE3938710A1; DE3419755A1; DE19941043A1; DE19941043B4

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0082438 A1 19830629; EP 0082438 B1 19851009; DE 3150985 A1 19830630; DE 3266873 D1 19851114; JP H026834 B2 19900214; JP S58113366 A 19830706; US 4493861 A 19850115; US 4622411 A 19861111

DOCDB simple family (application)

EP 82111461 A 19821210; DE 3150985 A 19811223; DE 3266873 T 19821210; JP 22510082 A 19821223; US 44904382 A 19821213; US 66466884 A 19841025